



# 平成24年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成24年4月2日

上場取引所 東

上場会社名 三益半導体工業株式会社

コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 中澤 正幸

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長

(氏名) 八高 達郎

TEL 027-372-2011

四半期報告書提出予定日 平成24年4月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成24年5月期第3四半期の業績(平成23年6月1日～平成24年2月29日)

### (1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年5月期第3四半期	31,659	△34.1	2,037	△42.6	1,899	△40.2	1,016	△45.2
23年5月期第3四半期	48,012	17.2	3,550	63.6	3,175	295.4	1,855	434.6

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年5月期第3四半期	30.36	—
23年5月期第3四半期	55.43	—

### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年5月期第3四半期	62,796	51,703	82.3
23年5月期	74,609	51,485	69.0

(参考) 自己資本 24年5月期第3四半期 51,703百万円 23年5月期 51,485百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年5月期	—	12.00	—	12.00	24.00
24年5月期	—	12.00	—		
24年5月期(予想)				12.00	24.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 平成24年5月期の業績予想(平成23年6月1日～平成24年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	42,000	△29.5	2,500	1.4	2,200	8.5	1,200	17.8	35.84

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

#### 4. その他

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

24年5月期3Q	35,497,183 株	23年5月期	35,497,183 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

24年5月期3Q	2,014,910 株	23年5月期	2,014,746 株
----------	-------------	--------	-------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年5月期3Q	33,482,370 株	23年5月期3Q	33,482,920 株
----------	--------------	----------	--------------

#### ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

#### ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「(3) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 財政状態に関する定性的情報 .....	2
(3) 業績予想に関する定性的情報 .....	2
2. 四半期財務諸表 .....	3
(1) 四半期貸借対照表 .....	3
(2) 四半期損益計算書 .....	5
(3) 継続企業の前提に関する注記 .....	6
(4) セグメント情報 .....	6
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	6

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期累計期間のわが国経済において、生産は緩やかに持ち直してきたものの、世界的な景気減速などの影響により依然として厳しい状況が続きました。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、東日本大震災後、サプライチェーンの復旧とともに生産に回復の動きが見られましたが、その後、半導体デバイス需要の悪化から調整局面に入るなど厳しい事業環境となりました。

このような経営環境の中で当社は、経営全般にわたる徹底した合理化や効率化の推進、省電力対策の実施など、総力を挙げて業績の改善に取り組みました。

当第3四半期累計期間の業績は、主に産商事業部の売上高が減少したことにより316億5千9百万円と前年同四半期比34.1%の減収となり、営業利益は20億3千7百万円(前年同四半期比42.6%減)、経常利益は18億9千9百万円(同40.2%減)、四半期純利益は10億1千6百万円(同45.2%減)となりました。

#### 半導体事業部

当事業部の生産は、期初より底堅く推移してきたものの、後半は半導体デバイスメーカーの生産の減少や在庫調整の影響を受けました。

#### 産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みましたが、厳しい経済環境を反映してその他の取扱商品において大幅な減収となりました。

#### エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割を担うとともに、産商事業部を通じた自社開発製品の販売活動を積極的に展開いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

### (2) 財政状態に関する定性的情報

当第3四半期会計期間末における総資産は、売上債権の減少等により、前事業年度末と比較して118億1千2百万円減少し、627億9千6百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により120億3千万円減少し、110億9千2百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加2億1千3百万円等により、517億3百万円となりました。

### (3) 業績予想に関する定性的情報

世界的な景気減速など厳しい事業環境が続いたことから、主に産商事業部の売上高が当初予想を下回る見通しとなりましたため、業績予想を修正いたします。詳細につきましては、本日平成24年4月2日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成23年5月31日)	当第3四半期会計期間 (平成24年2月29日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	20,051	17,462
受取手形及び売掛金	18,620	11,816
商品及び製品	154	212
仕掛品	374	444
原材料及び貯蔵品	911	933
その他	1,003	1,651
貸倒引当金	△20	△13
流動資産合計	41,096	32,508
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	15,453	14,395
その他(純額)	14,113	12,682
有形固定資産合計	29,567	27,078
無形固定資産		
	1,625	1,359
投資その他の資産		
その他	2,320	1,856
貸倒引当金	—	△6
投資その他の資産合計	2,320	1,850
固定資産合計	33,512	30,287
資産合計	74,609	62,796
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	16,550	7,861
短期借入金	100	100
引当金	95	425
その他	4,456	855
流動負債合計	21,201	9,243
固定負債		
長期借入金	350	300
退職給付引当金	1,383	1,362
その他	188	187
固定負債合計	1,922	1,849
負債合計	23,123	11,092

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成23年5月31日)	当第3四半期会計期間 (平成24年2月29日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	17,314	17,527
自己株式	△3,409	△3,409
株主資本合計	51,507	51,720
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△21	△16
評価・換算差額等合計	△21	△16
純資産合計	51,485	51,703
負債純資産合計	74,609	62,796

(2) 四半期損益計算書  
第3四半期累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自平成22年6月1日 至平成23年2月28日)	当第3四半期累計期間 (自平成23年6月1日 至平成24年2月29日)
売上高	48,012	31,659
売上原価	42,598	27,819
売上総利益	5,413	3,840
販売費及び一般管理費	1,863	1,803
営業利益	3,550	2,037
営業外収益		
受取利息	3	4
受取配当金	2	4
その他	60	17
営業外収益合計	66	27
営業外費用		
支払利息	1	2
設備休止費用	337	126
その他	102	35
営業外費用合計	441	164
経常利益	3,175	1,899
特別利益		
固定資産売却益	2	0
貸倒引当金戻入額	22	—
受取保険金	—	142
特別利益合計	24	143
特別損失		
固定資産売却損	30	0
固定資産除却損	12	36
減損損失	3	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	9	—
災害による損失	—	10
特別損失合計	55	47
税引前四半期純利益	3,144	1,995
法人税、住民税及び事業税	1,044	163
法人税等調整額	243	815
法人税等合計	1,288	979
四半期純利益	1,855	1,016

## (3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (4) セグメント情報

報告セグメントごとの売上高に関する情報

前第3四半期累計期間(自平成22年6月1日至平成23年2月28日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	23,252	24,273	485	48,012	—	48,012
セグメント間の内部売上高 又は振替高	5	—	1,185	1,191	△1,191	—
合計	23,258	24,273	1,671	49,203	△1,191	48,012

当第3四半期累計期間(自平成23年6月1日至平成24年2月29日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	18,986	12,673	—	31,659	—	31,659
セグメント間の内部売上高 又は振替高	3	—	1,353	1,356	△1,356	—
合計	18,989	12,673	1,353	33,016	△1,356	31,659

## (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。